

低温导电银胶

产品名称	低温导电银胶
公司名称	深圳市聚芯源新材料技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区A8栋101
联系电话	13537566612 18028708139

产品详情

导电银胶的基体树脂是一种胶粘剂,可以选择适宜的固化温度进行粘接,如环氧树脂胶粘剂可以在室温至150 固化,远低于锡铅焊接的200 以上的焊接温度,这就避免了焊接高温可能导致的材料变形、电子器件的热损伤和内应力的形成.同时,由于电子元件的小型化、微型化及印刷电路板的高密度化和高度集成化的迅速发展,铅锡焊接的0.65mm的*小节距远远满足不了导电连接的实际需求,而导电银胶可以制成浆料,实现很高的线分辨率.而且导电银胶工艺简单,易于操作,可提高生产效率,也避免了锡铅焊料中重金属铅引起的环境污染.所以导电银胶是替代铅锡焊接,实现导电连接的理想选择.

导电银胶已广泛应用于液晶显示屏(LCD)、发光二极管(LED)、集成电路(IC)芯片、印刷线路板组件(PCBA)、点阵块、陶瓷电容、薄膜开关、智能卡、射频识别等电子元件和组件的封装和粘接,有逐步取代传统的锡焊焊接的趋势。